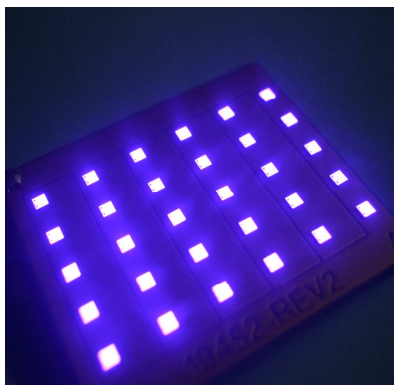


LED モジュール

高輝度LED実装基板等、LEDの発熱を抑える熱伝導性の優れたセラミック基板を使用した放熱対策用回路基板を提供致します。



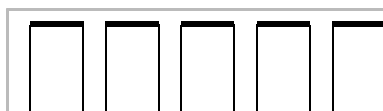
特徴

- ◆基板(アルミナ96%)は熱伝導性、耐熱、熱膨張、衝撃に優れています。
- ◆回路は弊社の主分野である厚膜印刷技術で優れた信頼性を提供します。
- ◆ガラエポ基板からの変更で、放熱効果を実現します。
- ◆アルミベース基板などLED用のサーマル基板からの変更で製品コストの削減となります。

明滅タイプ



点滅タイプ



定格 : 0.2W 25mA
色 : 2000K-6500K

組み合わせによりランダム点滅を実現します。

部 材 名	材 料 仕 様
LED	SMT実装型、チップLED
基 板	アルミナ基板
導 体	Ag-Pd系 厚膜印刷
オーバーコート	厚膜印刷(樹脂系) 黒 白 他
樹脂ケース	液晶ポリマー
充 填 樹 脂	光拡散剤入りエポキシ樹脂
端 子	鉄材、銅下地はんだメッキ (鉛フリー)
は ん だ	鉛フリーハンダ
捺印インク	UV硬化インク(黒色)

アルミナ基板96% 特性表

機械的特性	ビッカース硬度	13.7	GPa
	曲げ強度	350	MPa
熱的特性	線膨張係数	7.50E-06	/°C
	熱伝導率	23	W/(m・K)
電気的特性	絶縁耐圧	1.50E+07	V/m
	体積固有抵抗	>1.0E+15	Ω・cm
	誘電率	9.4	—